

お問合せ先
OBARA GROUP株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10
TEL. 046-271-2122

適切に選別された森林からの原料を含むFSC®認証紙と環境に配慮した植物油インキを使用
して造ります。



www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第57期 第2 四半期報告書

2014年10月1日 …… 2015年3月31日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2015年第2四半期連結累計期間(2014年10月1日から2015年3月31日まで)における事業の概況等をご報告致します。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国において景気回復の動きが持続したものの、アジア地域を始めとする新興国の経済成長の鈍化や欧州地域の不透明な景況感の継続などから、全体として低成長で推移しました。

我が国経済につきましては、個人消費が総じて底堅い動きを示す中、企業の生産活動に持ち直しが見られるなど、緩やかな景気回復が続きました。

そのような外部環境の中、溶接機器関連事業が自動車メーカーの活発な生産活動や設備投資による需要拡大への対応を継続的に展開したことや、平面研磨装置関連事業がエレクトロニクス業界の緩やかな回復基調において顧客ニーズの発掘と迅速対応に注力したことなどにより、当社の業績は、前年同期を上回る結果となりました。



なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、本年3月に256千株(自己株式を除く発行済株式総数の1.3%)の自己株式を取得するとともに、2015年度の第2四半期末配当金につきましては、1株につき30円とし、本年6月10日を支払開始日とさせていただきます。

今後も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2015年6月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	

営業の概況

連結業績サマリー

(百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	前期	当期	前期比	前期	当期(予想)	前期比
売上高	24,325	27,755	14.1%	47,761	55,000	15.2%
営業利益	5,038	5,969	18.5%	8,938	11,500	28.7%
経常利益	5,395	6,227	15.4%	9,656	11,900	23.2%
四半期(当期)純利益	3,576	3,695	3.3%	6,186	7,200	16.4%
1株当たり配当金	20円	30円	10円	70円(年間)	60円(年間)	△10円

(注) 前期配当金の内訳(確定)／第2四半期末配当20円・期末配当50円(期末配当の内訳 普通配当40円・記念配当10円)
 当期の第2四半期末配当(確定)／普通配当30円
 当期の期末配当(予想)／普通配当30円

03

第2四半期連結累計期間の概況について

溶接機器関連事業と深く関わる自動車業界では、中国を中心としたアジア地域と米州地域での自動車需要の拡大を背景として設備増強が行われるとともに、生産活動についても活発な動きが見られました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、総体的に設備投資及び生産活動の緩やかな回復が見られました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努めたことなどにより、第2四半期連結累計期間の業績は、前年同期に比べ増収増益となりました。

通期の見通しについて

第2四半期連結累計期間の業績及び足元の需要環境を踏まえて、平成27年4月30日に連結業績予想を上方修正しました。

溶接機器関連事業及び平面研磨装置関連事業とも日本を含むアジア地域での業績が順調に推移する見込みであることから、売上高550億円(前期比15.2%増)、営業利益115億円(前期比28.7%増)、経常利益119億円(前期比23.2%増)、当期純利益72億円(前期比16.4%増)を予定しております。なお、当連結業績予想は、1米ドル=118円の為替レートを前提としています。

04

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

●溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

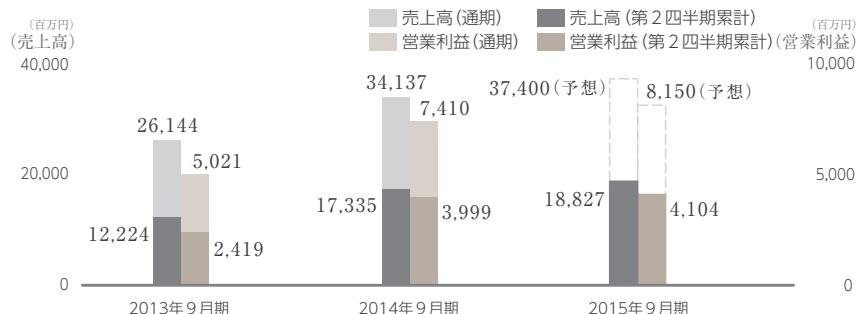
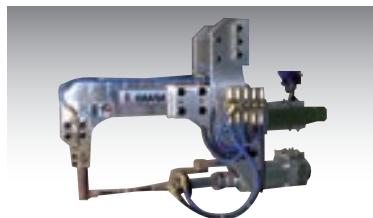
OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

溶接機器関連事業につきましては、取引先である日系・欧米系・アジア系自動車メーカーにおいて、中国を中心としたアジア地域や米州地域などで積極的な増産投資が行われ、世界各地の自動車生産は高水準となりました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったことなどにより、業績は堅調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は188億27百万円(前年同期比8.6%増)となり、同営業利益は41億4百万円(前年同期比2.6%増)となりました。

売上高構成比

27,755 百万円……2015年9月期
平面研削装置関連事業

溶接機器
関連事業

67.8%

セグメント別事業概況

平面研磨
装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

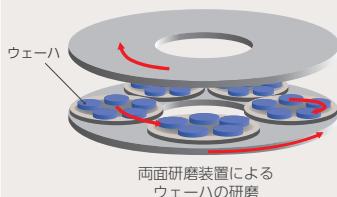
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載

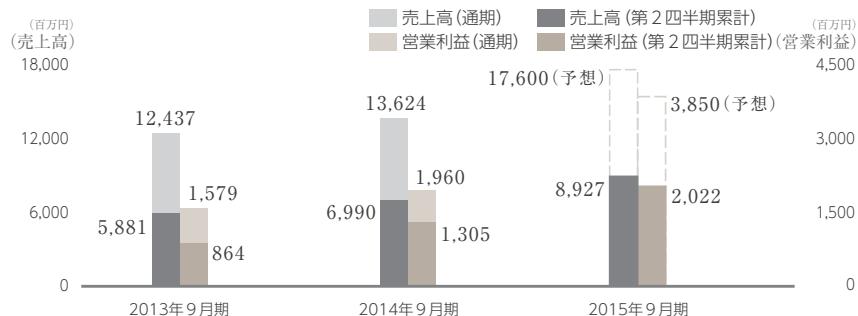


OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

平面研磨装置関連事業につきましては、スマートフォンなど主要エレクトロニクス製品の堅調な販売動向などを受け、取引先であるエレクトロニクス関連素材においても、設備投資及び生産活動に緩やかな回復が見られました。このような環境の下、当事業として顧客要求に適合した販売深耕を各業界へ努めたことなどにより、業績は好調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は89億27百万円(前年同期比27.7%増)、同営業利益は20億22百万円(前年同期比54.9%増)となりました。

売上高構成比



トピックス

溶接機器関連事業

ブラジルに販売拠点を設立

ブラジルでは、自動車マーケットが急速に拡大しており、過去10年間の年平均成長率は8%と高水準になっています。自動車メーカー各社は、中長期的な成長性を見込んで積極的な投資を行っています。当社グループとしても、同国での自動車ボディ向け溶接機器の需要増大へ対応するべく、2015年2月、サンパウロ州サン・ベルナルド・ド・カンポに販売拠点を設立しました。当社グループは、成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

ブラジル自動車販売実績

(全ての車種含む)

(単位：台)



09

平面研磨装置関連事業

SEMICON JAPANに出展

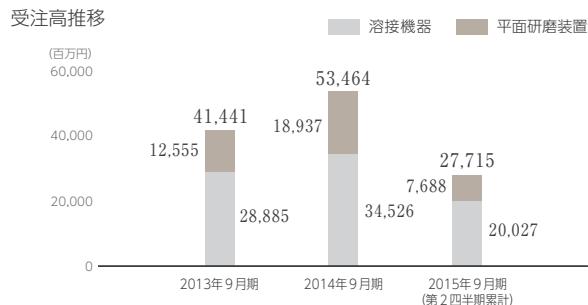
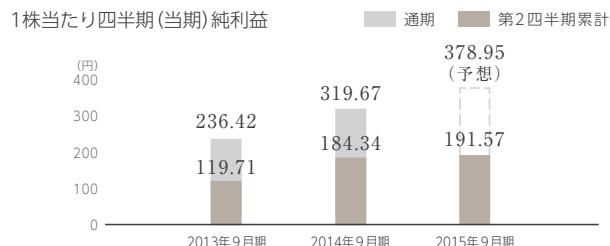
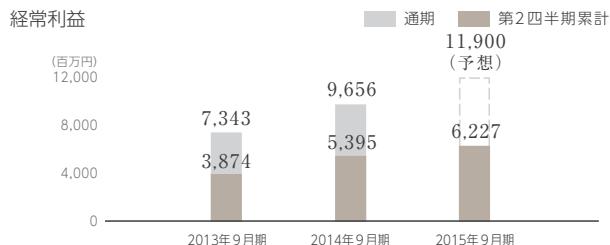
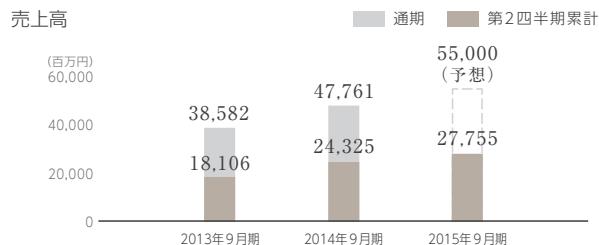
スマートフォンなどのエレクトロニクス製品には、最先端の半導体デバイスが搭載され、そのデバイスが形成されるシリコンウェーハの高精度化が進んでいます。2014年12月、半導体製造技術の展示会「SEMICON JAPAN」が東京ビッグサイトにて開催され、当社グループは、シリコンウェーハの要求品質へ高い生産性で応える研磨装置及び消耗副資材を紹介しました。また、様々な電子素材に向けた装置シリーズとそれらを組み合わせた効果的な製造プロセスについてもプレゼンテーションを行い、国内外から注目を集めました。



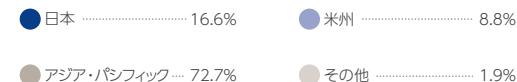
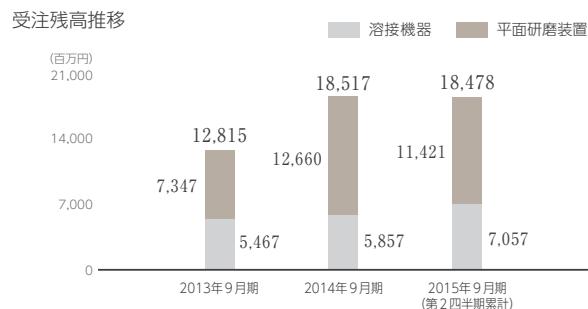
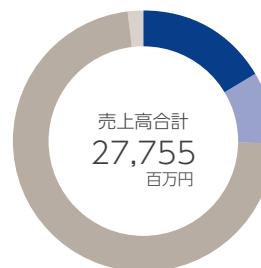
SEMICON JAPAN

10

主要経営指標の推移



地域別売上高構成比

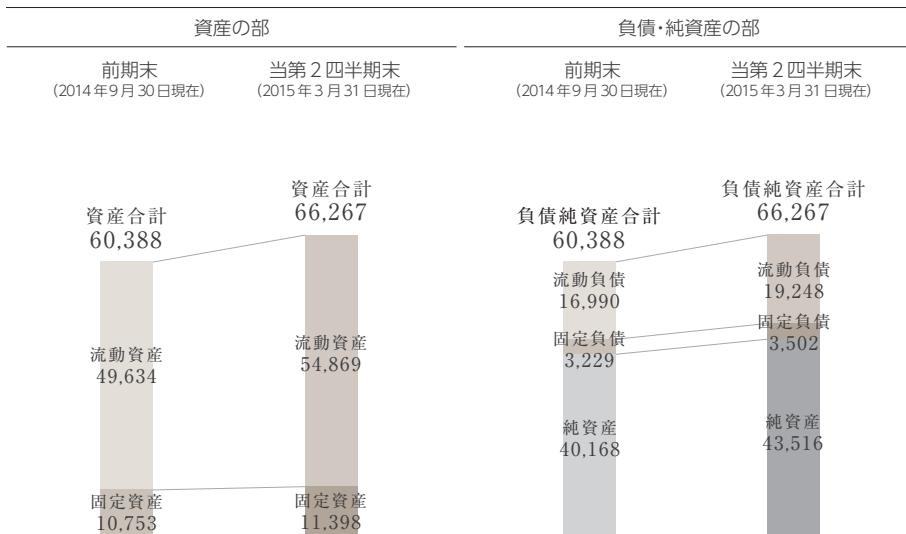


(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

連結財務データ

資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



資産・負債

point
1

総資産は662億67百万円と、前期末と比べて58億78百万円増加しました。現金及び預金が13億39百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が18億11百万円、有価証券が19億89百万円、棚卸資産が22億71百万円増加したことなどによります。

負債は227億51百万円と、前期末に比べて25億30百万円増加しました。賞与引当金が3億67百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が10億21百万円、短期借入金が15億39百万円増加したことなどによります。

純資産

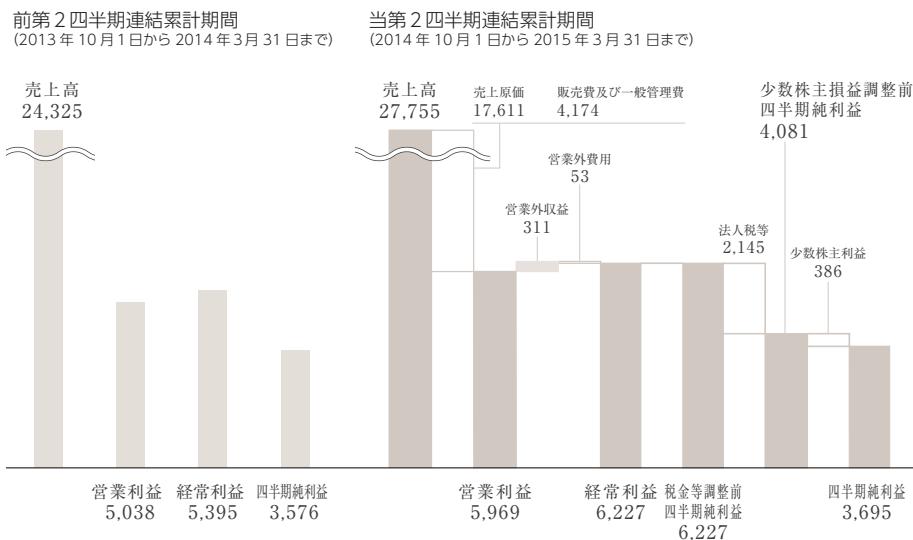
point
2

純資産は435億16百万円と、前期末に比べて33億48百万円増加しました。自己株式の取得により17億19百万円減少した一方、利益剰余金が27億30百万円、円安により為替換算調整勘定が19億52百万円増加したことなどによります。

13

損益の状況

(単位：百万円)



売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益

point
3

連結売上高277億55百万円(前年同期比14.1%増)、営業利益59億69百万円(前年同期比18.5%増)、経常利益62億27百万円(前年同期比15.4%増)、四半期純利益36億95百万円(前年同期比3.3%増)となりました。

営業外収支

point
4

受取利息1億32百万円、為替差益87百万円など、営業外収益が3億11百万円となった一方、支払利息21百万円など、営業外費用が53百万円となりました。

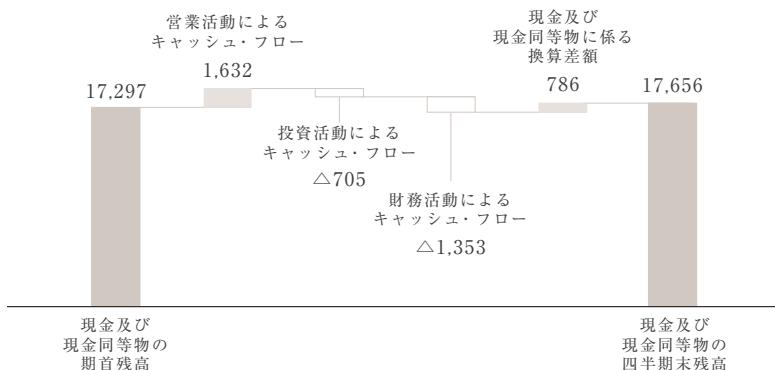
14

連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間
(2014年10月1日から2015年3月31日まで)

(単位：百万円)



point
5

営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、16億32百万円となりました。税金等調整前四半期純利益が62億27百万円などとなった一方、賞与引当金の減少額が4億19百万円、売上債権の増加額が5億94百万円、棚卸資産の増加額が15億90百万円、法人税等の支払額が17億92百万円発生したことなどによります。

point
6

投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は7億5百万円となりました。定期預金の純増加額が1億60百万円となった一方、有形固定資産の取得による支出が6億32百万円発生したことなどによります。

point
7

財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は13億53百万円となりました。短期借入金の純増加額が14億91百万円となった一方、自己株式の取得による支出が17億19百万円、配当金の支払額が9億65百万円発生したことなどによります。

会社情報 (2015年3月31日現在)

会社概要

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	21名(連結 1,643名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間3-2-10 046-271-1111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

取締役社長	小原 康 嗣
取締役	小林 憲 史
取締役	周 澤 健
取締役	山下 光 久
常勤監査役	谷 内 博
社外監査役	大 西 倫 雄
社外監査役	須 山 正 志

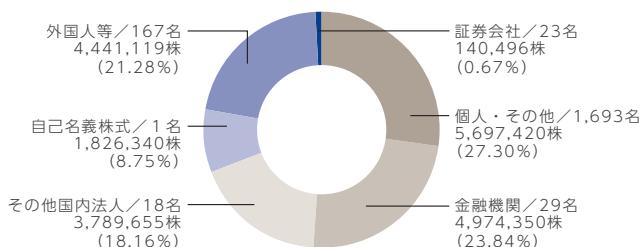
(注) 監査役のうち、大西倫雄及び須山正志の両名は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。

株式情報 (2015年3月31日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	1,931名

株主分布状況



大株主 (上位10名)

株主名	持株数(千株)	持株比率 (%)
有限会社馬込興産	3.703	19.44
小原 康嗣	2.261	11.87
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口)	1.221	6.41
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口9)	911	4.78
JP MORGAN CHASE BANK 385632	606	3.18
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口)	473	2.48
株式会社三菱東京UFJ銀行	369	1.94
CMBL S.A. RE MUTUAL FUNDS	368	1.93
小原 博	310	1.62
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019	309	1.62

- (注) 1. 上記のほか、自己株式1,826千株を保有しております。
 2. 持株比率は、自己株式1,826千株を控除して計算しております。
 3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数774千株を加えて表示しております。

株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月
基準日	定時株主総会の議決権 毎年9月30日 期末配当 毎年9月30日 第2四半期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

株主名簿管理人	〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所 (郵便物送付先 お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル)
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

公告方法 当社公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。
<http://www.obara-g.com/>
 但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行なうことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。